

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第1区分

【発行日】平成25年4月18日(2013.4.18)

【公表番号】特表2012-519137(P2012-519137A)

【公表日】平成24年8月23日(2012.8.23)

【年通号数】公開・登録公報2012-033

【出願番号】特願2011-552168(P2011-552168)

【国際特許分類】

C 04 B 38/00 (2006.01)

C 04 B 35/64 (2006.01)

【F I】

C 04 B 38/00 304Z

C 04 B 35/64 C

【手続補正書】

【提出日】平成25年2月26日(2013.2.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

粘土材料と有機材料とを含む原料を未焼成構造体の形態に形成する工程と、
前記未焼成構造体を焼成環境中で焼成する工程であって、前記焼成は、

前記未焼成構造体のコアのごく近傍で前記粘土材料の脱水が開始される前に前記実質的に有機材料の焼き払いを完了させるのに十分な第1の時間にわたり、焼成環境を第1の閾値温度を含む温度まで加熱すること、および

粘土脱水が起こる第2の時間にわたり、前記第1の閾値温度から前記第1の閾値温度より高い第2の閾値温度まで前記焼成環境を加熱すること、
を含むものである、焼成する工程と、
を含み、

前記第1の閾値温度から前記第2の閾値温度までの平均ランプ速度が、約11 / 時～約75 / 時の範囲内である、

方法により製造されることを特徴とする、多孔性セラミック構造体。

【請求項2】

前記第1の閾値温度が約425であることを特徴とする、請求項1に記載のセラミック構造体。

【請求項3】

前記第1の時間にわたり前記焼成環境を前記第1の閾値温度を含む温度まで加熱することが、約12 / 時以下の平均ランプ速度で前記焼成環境を加熱することを含むことを特徴とする、請求項2に記載のセラミック構造体。

【請求項4】

前記第2の閾値温度が約750であることを特徴とする、請求項1に記載のセラミック構造体。

【請求項5】

前記第1の時間にわたり前記焼成環境を前記第1の閾値温度を含む温度まで加熱することが、少なくとも所定の最短時間にわたり前記焼成環境を前記第1の閾値温度を含む温度まで加熱することを含むことを特徴とする、請求項1に記載のセラミック構造体。

【請求項 6】

前記第1の閾値温度が約400～約425の範囲内にあり、かつ前記所定の最小時間が約24時間～約46時間の範囲内にあることを特徴とする、請求項5に記載のセラミック構造体。